

CLB0HB5560K1000TC1

生産中

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,モバイル機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器,ルーター,Wi-Fiルーター,光電装装置,光通信モジュール,モバイル機器,基地局,RF用パワーアンプ,産業機器

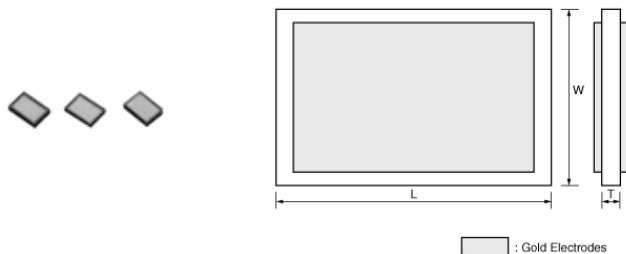
特長

1. なめらかで緻密なセラミクスと金電極を用いたシンプルな単板構造であるため、信頼性、周波数特性に優れています。
2. 超小型の0.25mm角からシリーズ化しており、回路の小型化、高密度実装に適しています。
3. 金電極を用いているので、AuSnによるダイボンディング、Au線によるワイヤーボンディングができます。
4. 実装性、取り扱い性を向上するために、AuSnを片面、両面にコートすることが可能です。
5. カタログ掲載品種以外の特殊仕様（サイズ、静電容量、その他）の対応も可能です。

■用途

各種マイクロ波集積回路（増幅器、発信機、ミキサ、制御回路等）光通信機器、移動体通信機器、計測機器。

外観および形状



お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

CLB0HB5560K1000TC1

スペック

形状	SMD
使用温度範囲	-55℃ ～ 125℃
LxW寸法	L 0.71 X W 0.38mm
T寸法	0.125mm
定格電圧	100Vdc
静電容量(25℃)	56pF
静電容量公差	±10%
静電容量変化率(-25 to 85℃)	±10%
耐電圧	250Vdc
絶縁抵抗	25℃：100000MΩ以上

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。